

NO.: G3363-0110 VERSION: **B** PAGE: 1

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的

貳、適用時機

參、注意事項

肆、操作步驟

伍、生效與修訂



NO.: G3363-0110 **VERSION:** В PAGE: 2

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的:

使機台維持量測準確度。

貳、適用時機:

- 1.每年2月、7月各校驗一次。
- 2.機台量測值有誤差時。

參、注意事項:

- 1.ELEVATOR 移動尚未停止時勿拿起CASSETTE。
- 2.上下貨時請勿碰觸到傳送手臂。
- 3.使用托盤時不可急托、拉。

肆、操作步驟:

- 1. 先用標準片量測,以手動旋轉THINKNESS鈕將量測讀值調整與標準片標示厚度相同。
- 2.拿一片WAFER使用研磨機研磨14.5MIL。
- 3.研磨過後的14.5MIL WAFER以游標卡尺量測上下左右4點的厚度,並將厚度標示於WAFER上。
- 4. 將標示厚度的14.5MIL WAFER放於ADE機台上量測,量測WAFER上下左右4點的厚度。
- 5. 量測出來的厚度讀值與標示WAFER上的厚度值進行比較
 - 5.1 無誤差則跳至 (6.) 步驟。
 - 5.2 有誤差則調整 ADE GAN 的 VR 鈕,旋轉 GAN的VR 鈕時讀值會改變,將讀值調整與 WAFER上標示的厚度相同。
- 6.WAFER傳出校驗完成

伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.